

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2021-053

通富微电子股份有限公司2021年度非公开发行股票A股股票预案

2021年9月

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通富微电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行股票A股股票,已于2021年9月24日召开第七届董事会第七次临时会议,审议通过了《通富微电子股份有限公司2021年度非公开发行股票A股股票预案》,现将相关内容公告如下,敬请广大投资者注意。

各持有公司股份的投资者均享有知情权,请广大投资者注意。通富微电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行股票A股股票,已于2021年9月24日召开第七届董事会第七次临时会议,审议通过了《通富微电子股份有限公司2021年度非公开发行股票A股股票预案》,现将相关内容公告如下,敬请广大投资者注意。

通富微电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行股票A股股票,已于2021年9月24日召开第七届董事会第七次临时会议,审议通过了《通富微电子股份有限公司2021年度非公开发行股票A股股票预案》,现将相关内容公告如下,敬请广大投资者注意。

通富微电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行股票A股股票,已于2021年9月24日召开第七届董事会第七次临时会议,审议通过了《通富微电子股份有限公司2021年度非公开发行股票A股股票预案》,现将相关内容公告如下,敬请广大投资者注意。

一、本次发行概况
(一)发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
(二)发行数量
本次发行股票的数量不超过550,000万股,募集资金总额不超过550,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额投入以下项目:
1.存储设备封装测试产线建设项目
2.高性能芯片封装测试产线建设项目
3.SG新一代通用产品封装测试项目
4.国产替代封装产品产线项目
5.封装测试装备及材料研发项目

二、募集资金投向
本次发行股票募集资金总额不超过550,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额投入以下项目:
1.存储设备封装测试产线建设项目
2.高性能芯片封装测试产线建设项目
3.SG新一代通用产品封装测试项目
4.国产替代封装产品产线项目
5.封装测试装备及材料研发项目

三、募集资金投向
本次发行股票募集资金总额不超过550,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额投入以下项目:
1.存储设备封装测试产线建设项目
2.高性能芯片封装测试产线建设项目
3.SG新一代通用产品封装测试项目
4.国产替代封装产品产线项目
5.封装测试装备及材料研发项目

四、募集资金投向
本次发行股票募集资金总额不超过550,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额投入以下项目:
1.存储设备封装测试产线建设项目
2.高性能芯片封装测试产线建设项目
3.SG新一代通用产品封装测试项目
4.国产替代封装产品产线项目
5.封装测试装备及材料研发项目

五、募集资金投向
本次发行股票募集资金总额不超过550,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额投入以下项目:
1.存储设备封装测试产线建设项目
2.高性能芯片封装测试产线建设项目
3.SG新一代通用产品封装测试项目
4.国产替代封装产品产线项目
5.封装测试装备及材料研发项目

六、募集资金投向
本次发行股票募集资金总额不超过550,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额投入以下项目:
1.存储设备封装测试产线建设项目
2.高性能芯片封装测试产线建设项目
3.SG新一代通用产品封装测试项目
4.国产替代封装产品产线项目
5.封装测试装备及材料研发项目

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	存储设备封装测试产线建设项目	95,560.00	71,600.00
2	高性能芯片封装测试产线建设项目	90,026.00	82,856.00
3	SG新一代通用产品封装测试项目	99,200.00	90,850.00
4	国产替代封装产品产线项目	97,868.00	88,844.00
5	封装测试装备及材料研发项目	56,715.00	50,000.00
6	封装测试装备及材料研发项目	165,000.00	165,000.00
	合计	612,374.00	550,000.00

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	存储设备封装测试产线建设项目	95,560.00	71,600.00
2	高性能芯片封装测试产线建设项目	90,026.00	82,856.00
3	SG新一代通用产品封装测试项目	99,200.00	90,850.00
4	国产替代封装产品产线项目	97,868.00	88,844.00
5	封装测试装备及材料研发项目	56,715.00	50,000.00
6	封装测试装备及材料研发项目	165,000.00	165,000.00
	合计	612,374.00	550,000.00

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	存储设备封装测试产线建设项目	95,560.00	71,600.00
2	高性能芯片封装测试产线建设项目	90,026.00	82,856.00
3	SG新一代通用产品封装测试项目	99,200.00	90,850.00
4	国产替代封装产品产线项目	97,868.00	88,844.00
5	封装测试装备及材料研发项目	56,715.00	50,000.00
6	封装测试装备及材料研发项目	165,000.00	165,000.00
	合计	612,374.00	550,000.00

五、募集资金投向
本次发行股票募集资金总额不超过550,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额投入以下项目:
1.存储设备封装测试产线建设项目
2.高性能芯片封装测试产线建设项目
3.SG新一代通用产品封装测试项目
4.国产替代封装产品产线项目
5.封装测试装备及材料研发项目

六、募集资金投向
本次发行股票募集资金总额不超过550,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额投入以下项目:
1.存储设备封装测试产线建设项目
2.高性能芯片封装测试产线建设项目
3.SG新一代通用产品封装测试项目
4.国产替代封装产品产线项目
5.封装测试装备及材料研发项目

七、募集资金投向
本次发行股票募集资金总额不超过550,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额投入以下项目:
1.存储设备封装测试产线建设项目
2.高性能芯片封装测试产线建设项目
3.SG新一代通用产品封装测试项目
4.国产替代封装产品产线项目
5.封装测试装备及材料研发项目

八、募集资金投向
本次发行股票募集资金总额不超过550,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额投入以下项目:
1.存储设备封装测试产线建设项目
2.高性能芯片封装测试产线建设项目
3.SG新一代通用产品封装测试项目
4.国产替代封装产品产线项目
5.封装测试装备及材料研发项目

九、募集资金投向
本次发行股票募集资金总额不超过550,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额投入以下项目:
1.存储设备封装测试产线建设项目
2.高性能芯片封装测试产线建设项目
3.SG新一代通用产品封装测试项目
4.国产替代封装产品产线项目
5.封装测试装备及材料研发项目

十、募集资金投向
本次发行股票募集资金总额不超过550,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额投入以下项目:
1.存储设备封装测试产线建设项目
2.高性能芯片封装测试产线建设项目
3.SG新一代通用产品封装测试项目
4.国产替代封装产品产线项目
5.封装测试装备及材料研发项目

通富微电子股份有限公司关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施及承诺的公告

一、本次发行摊薄即期回报的原因
二、填补措施
三、承诺事项

通富微电子股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告

一、处罚或监管措施情况
二、整改措施及整改情况

通富微电子股份有限公司关于本次非公开发行股票A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

一、本次发行概况
二、不存在提供财务资助或补偿的情况

通富微电子股份有限公司召开2021年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议议题
三、会议时间
四、会议地点
五、会议方式
六、会议登记
七、会议费用
八、其他事项

通富微电子股份有限公司关于本次非公开发行股票A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

一、本次发行概况
二、不存在提供财务资助或补偿的情况

通富微电子股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

一、会议基本情况
二、会议决议

通富微电子股份有限公司关于本次非公开发行股票A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

一、本次发行概况
二、不存在提供财务资助或补偿的情况

通富微电子股份有限公司关于本次非公开发行股票A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

一、本次发行概况
二、不存在提供财务资助或补偿的情况

通富微电子股份有限公司关于本次非公开发行股票A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

一、本次发行概况
二、不存在提供财务资助或补偿的情况

通富微电子股份有限公司关于本次非公开发行股票A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

一、本次发行概况
二、不存在提供财务资助或补偿的情况

通富微电子股份有限公司关于本次非公开发行股票A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

一、本次发行概况
二、不存在提供财务资助或补偿的情况

通富微电子股份有限公司关于本次非公开发行股票A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

一、本次发行概况
二、不存在提供财务资助或补偿的情况

通富微电子股份有限公司关于本次非公开发行股票A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

一、本次发行概况
二、不存在提供财务资助或补偿的情况

通富微电子股份有限公司关于本次非公开发行股票A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

一、本次发行概况
二、不存在提供财务资助或补偿的情况

通富微电子股份有限公司关于本次非公开发行股票A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

一、本次发行概况
二、不存在提供财务资助或补偿的情况

通富微电子股份有限公司关于本次非公开发行股票A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

一、本次发行概况
二、不存在提供财务资助或补偿的情况

通富微电子股份有限公司关于本次非公开发行股票A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

一、本次发行概况
二、不存在提供财务资助或补偿的情况

通富微电子股份有限公司关于本次非公开发行股票A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

一、本次发行概况
二、不存在提供财务资助或补偿的情况